УДК 621.315.592

## МАРКОВСКИЙ Е. П.

## ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ТЕРМООБРАБОТКИ НА УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ОМИЧЕСКОГО КОНТАКТА К МОНОКРИСТАЛЛАМ GAAS *P*-ТИПА

Исследовано значение удельного контактного сопротивления омических контактов к сильнолегированному полупроводнику ( $2\cdot 10^{18}~{\rm cm}^{-3}$ ) GaAs p-типа, с многослойной структурой контакта — Au/TiB $_{\rm x}$ Ti. Результаты измерений показывают, что данная омическая система конкурентоспособна и имеет свои преимущества перед другими подобными омическими структурами.

**Введение.** Формирование омических контактов к арсениду галлия p-типа связано с трудностью подбора металла, с работой выхода большей, чем из полупроводника. Поэтому до настоящего времени остается актуальной задача создания омического контакта даже к сильнолегированному  $p^+$ -GaAs, [1—11]. Цель данной работы — исследование влияния режимов термообработки на величину удельного сопротивления омического контакта  $R_{\rm K}$ , изготовленного на основе многослойной структуры — Au/TiB $_{\rm x}$ /Ti, к легированной кремнием до концентрации  $2\cdot 10^{18}~{\rm cm}^{-3}$ , полупроводниковой подложке GaAs p-типа, с плоской и текстурированой поверхностью, до и после термической обработки.

**Образцы и метод измерений.** Контактные слои создавались методом магнетронного распыления мишеней на предварительно обработанные методом фотонной очистки плоские и текстурированные поверхности  $p^+$ -GaAs.

Слой титана толщиной  $\sim\!100\,\text{Å}$  наносился на подогретую до 350 °C подложку, толщина буферного слоя  $\mathrm{TiB}_{x}$  и металлизации Au составляли 800 и 3000 Å соответственно.

Контактные площадки диаметрами 20...180 мкм с шагом 20 мкм, и диаметром 400 мкм, формировались методом фотолитографии. Пластина разделялась на 3 части: исходную, отожженную в атмосфере водорода при 500 и 600 °C.

Расчет удельного контактного сопротивления производился по методу растирания тока (метод Коса—Стрека). Измерения производились на образцах с различной площадью контакта, различной текстуризацией поверхности полупроводника и температурной обработкой. Полученные значения удельного сопротивления омического контакта при различных режимах температурной обработки составили  $0.8 \cdot 10^{-4}$ ,  $1.08 \cdot 10^{-4}$ ,  $1.22 \cdot 10^{-4}$  Ом·см<sup>2</sup>, для исходной и отожженных при 500 и 600 °C соответственно.

Для определения удельного контактного сопротивления по измеренному полному сопротивлению  $R_0$  экспериментальных образцов использовался метод растекания тока (Косса—Стрека), точность которого порядка  $10^{-6}$  Ом·см<sup>2</sup> [12, 13]. Удельное контактное сопротивление можно определить из измерений полного сопротивления исследуемой структуры омического контакта [13]:

$$R_0 = \frac{\rho_{\pi}}{\pi d} \arctan\left(\frac{4t}{d}\right) + \frac{4R_{\kappa}}{\pi d^2},\tag{1}$$

где  $\rho_{\rm II}$  — удельное сопротивление полупроводника, t — его толщина, d — диаметр контакта,  ${\rm arctg}(4t/d)$  учитывает растекание тока в полупроводнике.

Для реализации этого метода нужно измерить несколько десятков сопротивлений для разных диаметров и построить график зависимости удельного общего сопротивления структуры от диаметра электрода. Для идеализированного случая это должна быть прямая, которую можно описать уравнением: a=B+Kx, где  $a=R_0S$  (здесь S — площадь контакта), x=d/4 аrctg(4t/d). Точка пересечения прямой с осью  $y, B=R_{\rm K}$ , а тангенс угла наклона прямой  $K=\rho_{\rm II}$ . Для всех образцов измерения полного контактного сопротивления проводились по двузондовой схеме. Образцы GaAs p-типа, отожженные при 500 и 600 °C с диаметрами 60...120 мкм измерялись по однозондовой схеме.

**Результаты измерений и обсуждение.** По результатам измерения полного сопротивления омических контактов для диаметра 400 мкм на всех образцах, — проанализированы гистограммы разброса значений  $R_0$ . Оказалось, что исходные образцы обладают большим диапазоном разброса  $R_0$ , чем отожженные образцы — 0,1705...0,2325 Ом. Полученную гистограмму можно описать нормальным законом распределения (Гауссовский закон). Однако среднестатистическое значение и среднее значение  $R_0$  несколько отличаются, а именно